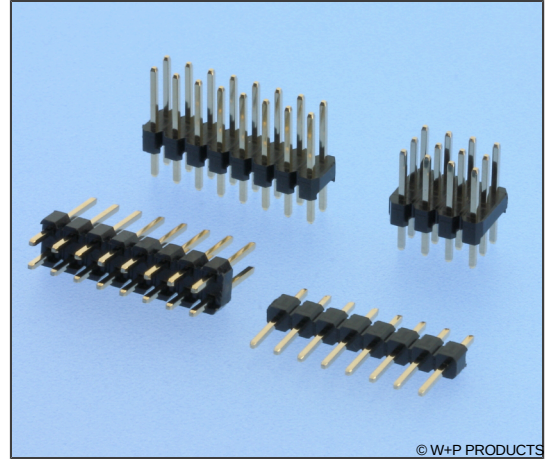


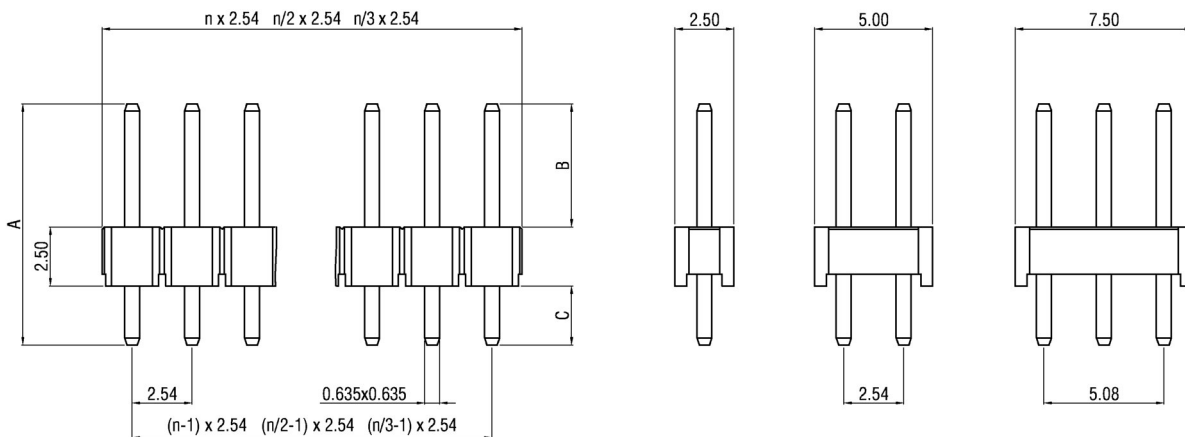
Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper <i>Insulator</i>	Thermoplast, nach UL94 V-0 <i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>
Kontaktmaterial <i>Contact Material</i>	Vierkantstift 0,635mm, Kupferlegierung <i>0.635mm square pin, copper alloy</i>
Kontaktfläche <i>Contact Surface</i>	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni <i>Acc. to options (see below), over Ni</i>
RoHS-Ausnahmen 6a-I / 6c <i>RoHS Exemptions 6a-I / 6c</i>	keine <i>none</i>
Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i>	< 20 mΩ <i>< 20 mΩ</i>
Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i>	> 1000 MΩ <i>> 1000 MΩ</i>
Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i>	1 kV DC <i>1 kV DC</i>
Nennspannung <i>Voltage Rating</i>	250 V AC <i>250 V AC</i>
Nennstrom <i>Current Rating</i>	3 A <i>3 A</i>
Temperaturbereich <i>Temperature Range</i>	-40 °C ... +125 °C <i>-40 °C ... +125 °C</i>
Verarbeitung <i>Processing</i>	Wellen- oder Reflow-Lötverfahren <i>Wave or reflow soldering</i>



© W+P PRODUCTS

Passende Buchsenleisten:
Compatible Female Headers:
153 154 157 159 160/162 349 624 etc.
Weitere siehe Kapitel B
Please see ch. B for more



PCB Layouts und Detailzeichnungen s. tech. Informationen / Seite A12
Please note tech. information / page A12 for PCB layouts and detailed drawings.

Series*

944

Gestanzte/geprägte Kontakte
Stamped/formed contacts
943 Einreihig
Single row
944 Zweireihig
Double row
945 Dreireihig
Triple row

Dimensions*

10

10 A=10,20 B=5,20 C=2,50mm
11 A=10,80 B=5,80 C=2,50mm
12 A=11,30 B=5,50 C=3,30mm
13 A=12,60 B=6,80 C=3,30mm
14 A=13,90 B=8,10 C=3,30mm
15 A=14,70 B=8,90 C=3,30mm
16 A=17,70 B=11,90 C=3,30mm
17 A=19,80 B=14,00 C=3,30mm
18 A=21,60 B=15,80 C=3,30mm
19 A=22,80 B=17,00 C=3,30mm
20 A=24,90 B=19,10 C=3,30mm
A/B/C Gesamtlänge & Wunschnmaße
Total length & Dimensions

Contacts*

010

001-050 Einreihig
Single row
004-100 Zweireihig
Double row
009-120 Dreireihig
Triple row

Plating*

00

00 Au flash
110 Sel. Au 0,25µm / Au flash
130 Sel. Au 0,75µm / Au flash
50 Sn
66 Sel. Au flash / Sn
610 Sel. Au 0,25µm / Sn
80 Sel. Au 0,75µm / Sn
Au flash <= 0,1µm
Au flash <= 0,1µm

Wir fertigen die Stiftleisten in jeder gewünschten Polzahl.
Raster 5,08mm, 7,62mm, etc. oder Sonderraster sowie
weitere Stiftlängen und Abmessungen auf Anfrage.
Bestellseite "Sonderbestückungen bei Stiftleisten" unter
Techn. Informationen.

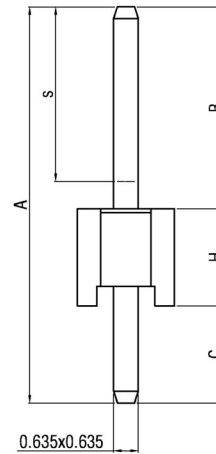
We will manufacture the pin headers in every desired
number of contacts. 5.08mm, 7.62mm, etc. and varying
itches as well as more dimensions on request. Order
page "Customer-specific Pin Configurations" in Technical
Information.

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** -
please replace by your specifications.

Gerade Stiftleisten

A : Gesamtstiftlänge
B : Länge Steckseite
C : Länge Lötseite
H : Höhe Isolierkörper
s : Bereich der sel. Veredelung

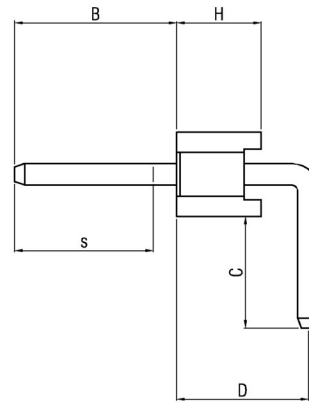
Messpunkt für **s** bei 2-4mm von der Stiftspitze.



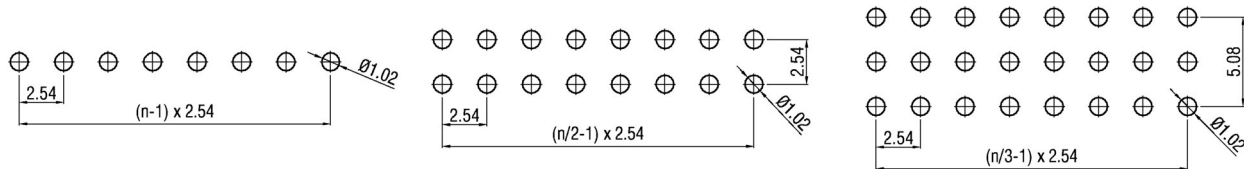
Gewinkelte Stiftleisten

B : Länge Steckseite
C : Länge Lötseite
D : Abstand zu Steckseite
H : Höhe Isolierkörper
s : Bereich der sel. Veredelung

Messpunkt für **s** bei 2-4mm von der Stiftspitze.



PCB Layouts



Informationen zum Reflow-Lötverfahren Reflow Soldering Information

Reflow-Lötempfehlung für kurze Lötzeiten

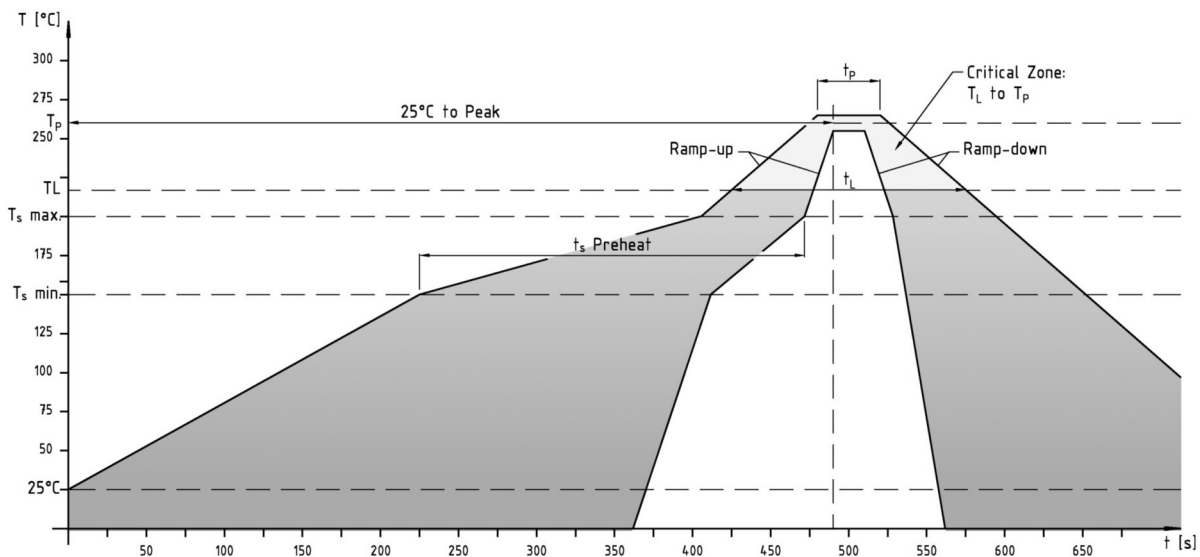
Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum T_{Smin}	150 °C
Temperatur Maximum T_{Smax}	200 °C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Temperatur Lötbereich T_L	217 °C
Verweildauer oberhalb T_L	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Höchsttemperatur T_P	260±5 °C
Dauer Höchsttemperatur	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Dauer 25 °C – Höchsttemperatur T_P	max. 8m

Reflow Soldering Recommendation For Shorter Peak Times

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature T_{Smin}	150 °C
Maximum Temperatur T_{Smax}	200 °C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Soldering Range Temperature T_L	217 °C
Duration above T_L	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Peak Temperature T_P	260±5 °C
Duration Peak Temperature	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Duration 25 °C - Peak Temp. T_P	max. 8min

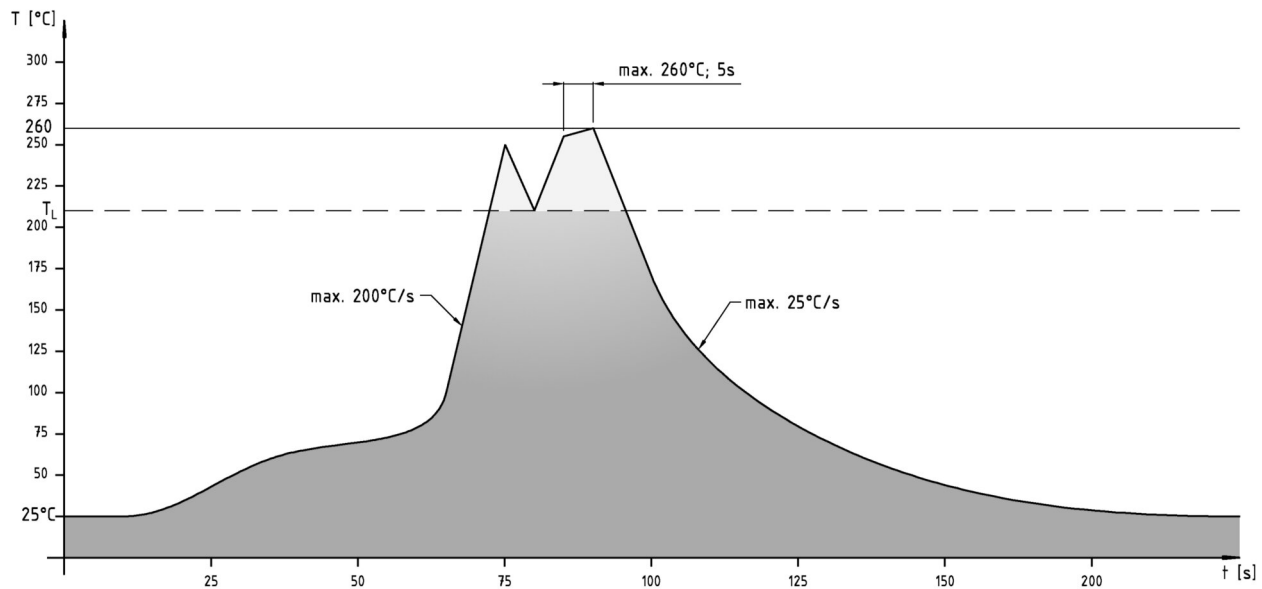


Empfehlungen für das Wellenlötverfahren

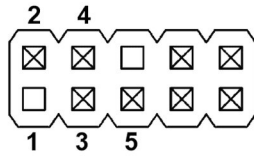
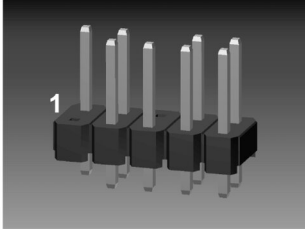
Recommendations for Wave Soldering

Die Bauteile sollten bei einer Lötbadtemperatur von 260°C in max. 5 Sekunden verlötet werden.

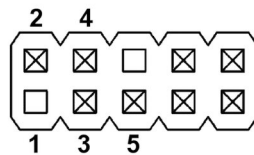
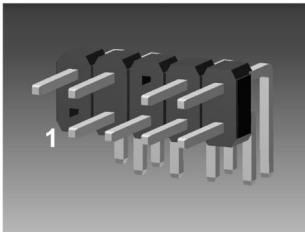
Empfohlenes Wellenlötprofil:



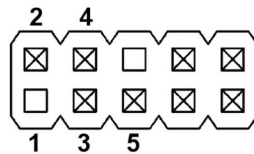
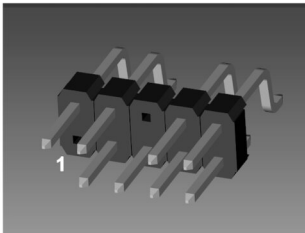
Gerade Stiftleisten, Sandwich-Stiftleisten, SMT-Stiftleisten stehend - 1-, 2-, 3-reihig
Straight Pin Headers, Dual Body Pin Headers, Vertical SMT Pin Headers - Single, Double, Triple Row



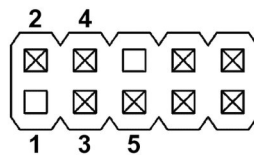
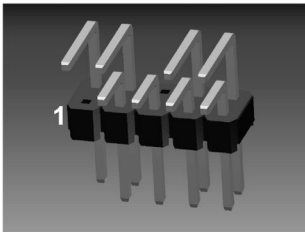
Gewinkelte Stiftleisten 1-, 2-, 3-reihig
Right-angled Pin Headers Single, Double, Triple Row



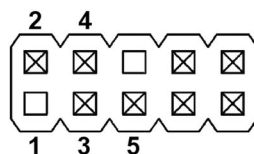
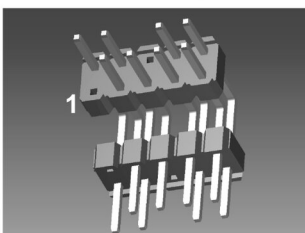
Liegende SMT-Stiftleisten 1-, 2-reihig
Horizontal SMT Pin Headers, Single, Double Row



Steckseitig gewinkelte Stiftleisten 1-, 2-reihig
Right-angled Mating Side Pin Headers Single, Double Row



Gewinkelte Sandwich-Stiftleisten 1-, 2-, 3-reihig
Right-angled Dual Body Pin Headers Single, Double, Triple Row



Serie / Bestellcode
Series / Order Code

☒ bestückt / assembled
☐ unbestückt / empty

Bestückungsschema
Assembly Pattern

